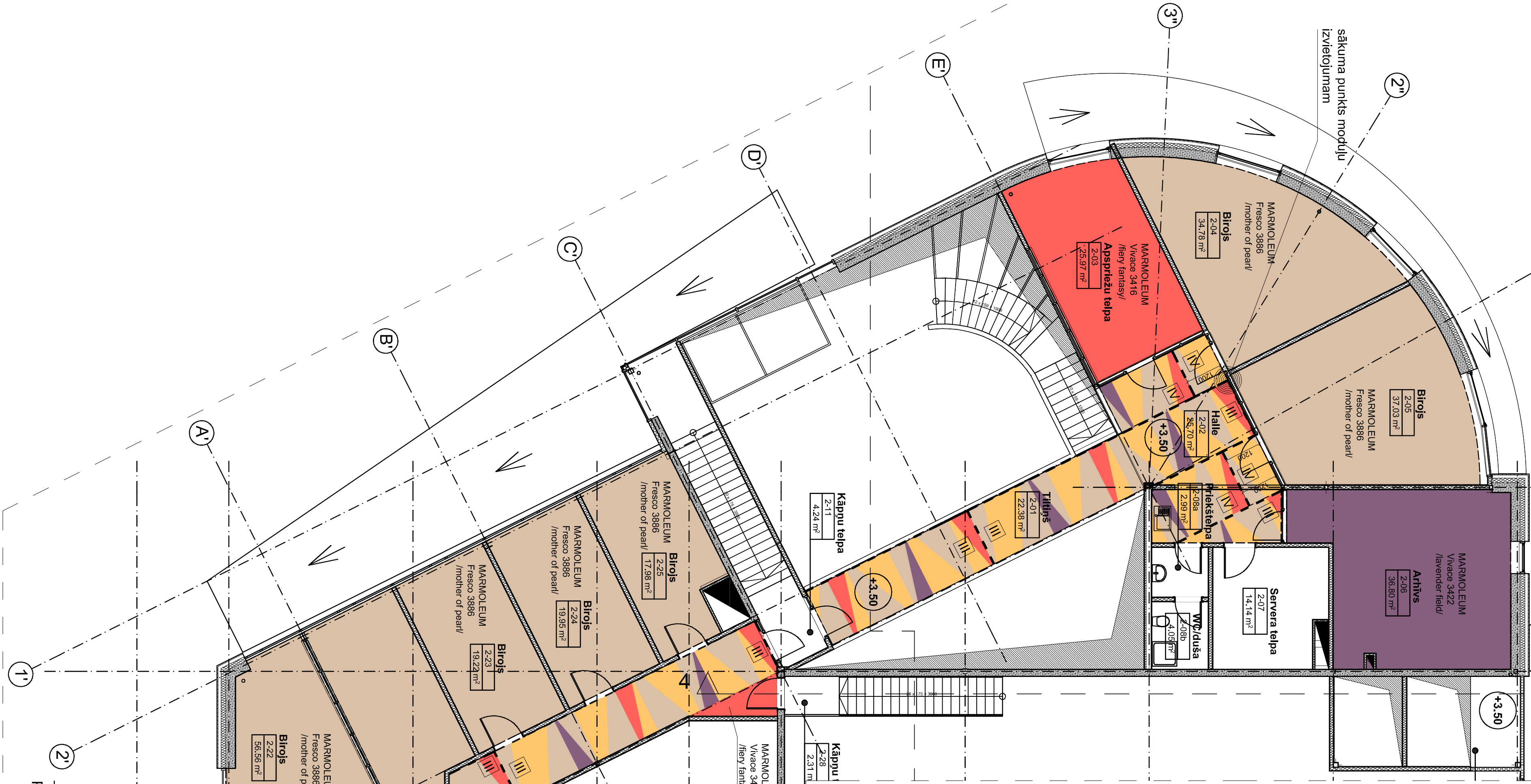
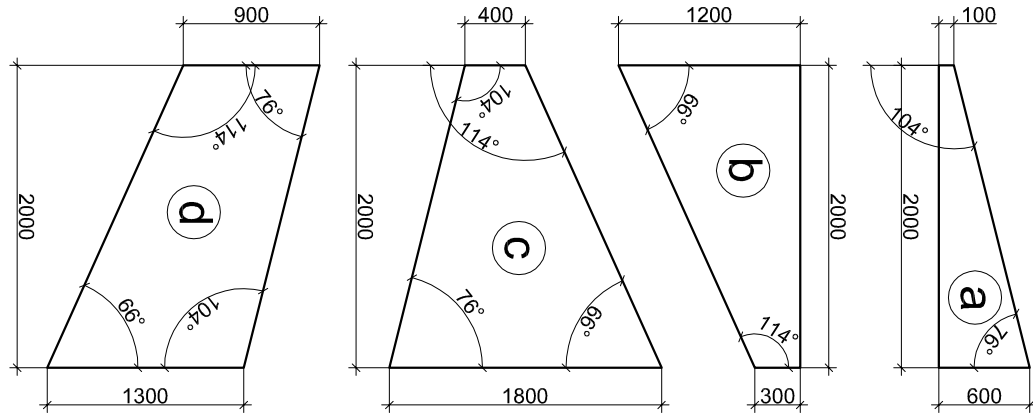


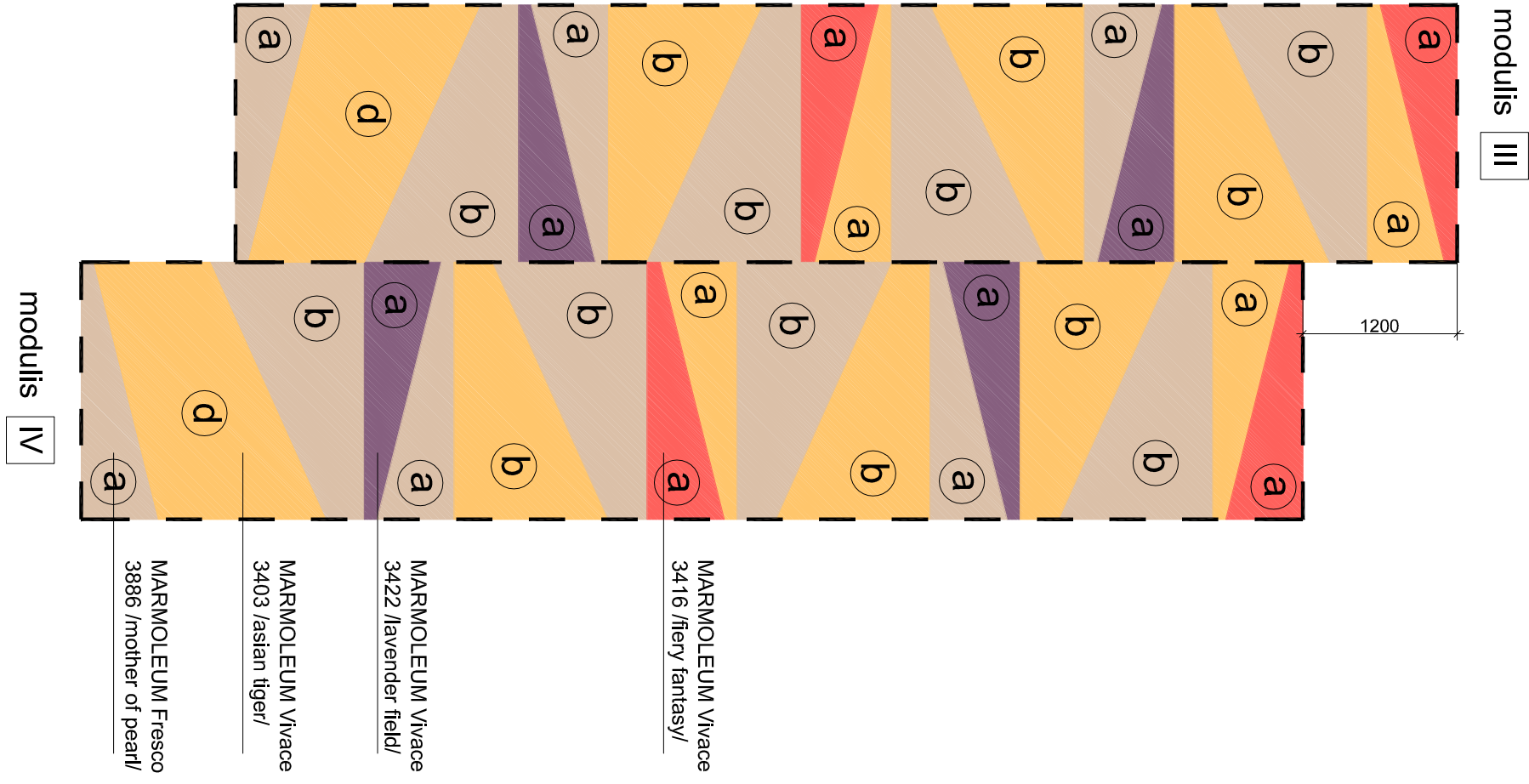
2. stāva plāna fragments
M1:100



elementu zīmējums M1:50



moduļu zīmējums M1:50



- PIEZĪMES:
- Grīdu segumu modulis veidots ņemot vērā izvērtētā inovatīva rīļa pieturumu, izvēloties cita ražotāja materiālus, saskaņojot moduļa risinājumu ar arhitektu-autoruuzraugu.
 - Šuvēm izmantot Marmoweld MC deudzkrāsaino melnāno auktu. Šuvju tonus skatīt ar arhitektu-autoruuzraugu.

Atbildīgais projektētājs		ARHITEKTU BIROJS SIA "VP"	
BRV		RALFS ROZENVALDS	
Arhitektūras daļas		RALFS ROZENVALDS	
Arhitekta		ELINA ROŽULAPA	
Arhitekta		KRISTĪNE KRAKOPE	
Pasūtītājs		Pasaūt. Nr.	
Ventisplis Bīrvostas pārvalde		VP-EC-12	
Opcija		Sīdriņa	
Elektronikas centra ēka Ventisplis		TP	
Augsto tehnoloģiju parkā		Lapa	
(bij. Kaiju iela 9), Ventisplis		INT-114	
Fāze		Mērogs	
plāns 2. stāvs.dwg		M 1:50,1:100	
Rasījums		Arh. reg. Nr.	
2. stāva plāna fragments		Datums	
ar grīdu segumiem		27.01.2014	